AUTOMAZIONE NELLA SALDATURA CON GRUPPO IIS IN UCIMU

Terza edizione di Feel Weld!, convegno dedicato agli sviluppi tecnologici e automazione dei processi nel settore saldatura organizzato dal Gruppo IIS, in programma il 31 maggio 2018 a Milano presso la sede di Ucimu. L'evento dal titolo 'Recenti sviluppi e indirizzi per robotica, sensoristica e intelligenza artificiale applicati alla saldatura' intende porre l'attenzione sugli aspetti che, in un momento di forte cambiamento per l'industria a livello globale, rendono sempre più irrinunciabili queste soluzioni innovative nei processi di fabbricazione mediante saldatura. Durante il convegno verranno presentate memorie digitali di alto livello realizzate da realtà del settore saldatura, Roboteco, Magneti Marelli, OMT, Nuovo Pignone Tecnologie, Lincoln Electric Italia, O.ME.P Officine Meccaniche Pierallini, Bazzana F.lli, Cadline, Ecor International, Multitel Pagliero, img Roboter systems, T.S.M., Calcom ESI SA -ESI Group. Otto aziende leader di settore presenteranno inoltre le loro proposte sviluppate in ambito saldatura, Maus Italia, Migatronic, Roboteco, Tecnorobot, Esab Saldatura, Siad, Link Industries, Lincoln Electric Italia. Maus Italia, Migatronic, Tecnorobot, Esab Saldatura e SIAD saranno inoltre presenti con un proprio desk. Il programma completo dell'evento è consultabile alla pagina sul sito IIS https://www.iis.it/news/feel-weld-3-sentire-la-saldatura-0. La partecipazione all'evento accredita CFP per Ingegneri iscritti agli Ordini territoriali italiani.

Codice abbonamento: 132292

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.